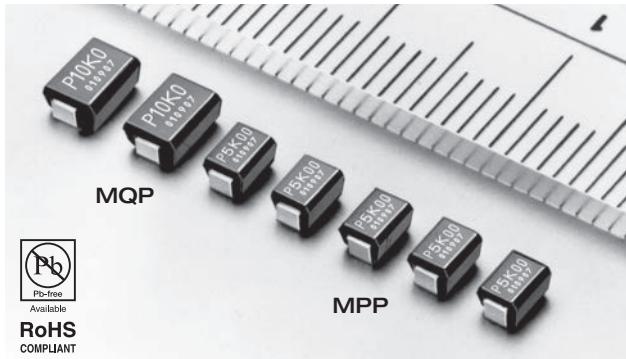


Z フォイル超精密チップ抵抗器（フェースボンド形）



特長

新世代Zフォイルテクノロジーにより

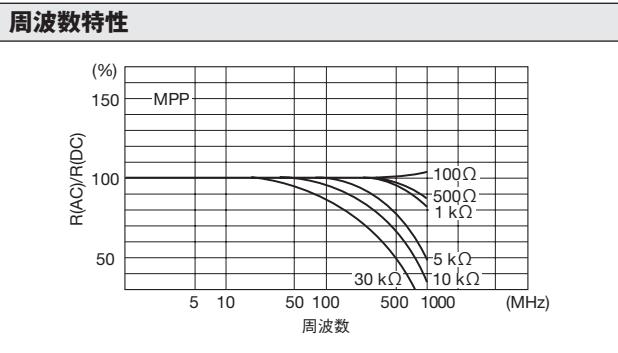
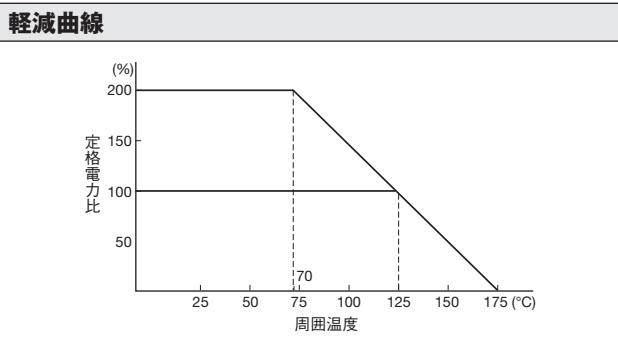
- 抵抗温度特性 (TCR) : 0.05 ppm/°C 代表値 (0°C ~ +60°C)
- 0.2 ppm/°C 代表値 (-25°C ~ +125°C, +25°C 基準)
- 抵抗値許容差: ±0.01%
- 電力係数 (自己発熱によるΔR) : 5 ppm/定格電力 代表値
- 70°C以下の周囲温度では2倍の定格電力にて使用可能
- 負荷寿命 : 0.005% 代表値 (70°C、2000時間、定格電力)
- 任意の抵抗値 (5桁まで) で製作可能 (追加費用 & 追加納期なし)

形名の構成			
例 :			
MPP 10K005* T L			
 テーピング仕様の場合 抵抗値許容差 公称抵抗値 形式			
抵抗値の表示は5有効数字1英文字とします。小数点は R (Ωレンジ)、K (kΩレンジ) を用います。			
* 製品への表示は3桁までとなりますがデータコードによりトレース可能です			

形 状		
形式	MPP	MQP
L	3.2±0.2	4.5±0.2
W	2.5±0.2	3.2±0.2
H	2.0±0.2	
L ₁	0.6±0.2	0.8±0.2
W ₁	1.4±0.3	
W ₂	2.3±0.2	3.0±0.2
H ₁	1.5±0.3	
t	0.15±0.05	

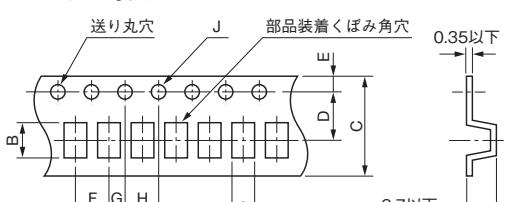
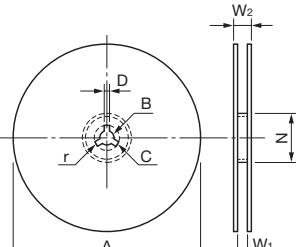
単位 (mm)

温度特性、抵抗値範囲、許容差、定格				
形式	抵抗温度特性 (ppm/°C) -25°C ~ +125°C	抵抗値範囲 (Ω)	抵抗値許容差 (%)	定格電力 (W) at 125°C
MPP	±0.2±3.8	30 ~ <50	±0.1(B)	0.1
	±0.2±2.8	50 ~ <100	±0.1(B)	
	±0.2±1.8	100 ~ <1k	±0.02(Q) ±0.05(A) ±0.1(B)	
	±0.2±1.8	1k ~ ≤30k	±0.01(T) ±0.02(Q) ±0.05(A) ±0.1(B)	
MQP	±0.2±3.8	30 ~ <50	±0.1(B)	0.125
	±0.2±2.8	50 ~ <100	±0.1(B)	
	±0.2±1.8	100 ~ <1k	±0.02(Q) ±0.05(A) ±0.1(B)	
	±0.2±1.8	1k ~ ≤60k	±0.01(T) ±0.02(Q) ±0.05(A) ±0.1(B)	

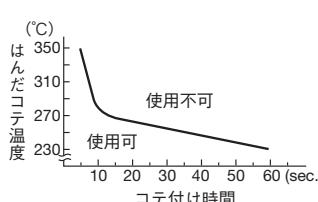
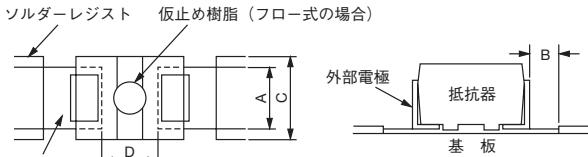


項目	試験条件	規格値		MPP/MQP 代表値*
		MP/MQ	MPP/MQP	
最高定格動作温度				125°C
使用温度範囲				-65°C ~ +175°C
最高使用電圧				MPP = 50V, MQP = 100V
最高使用電流				350 mA
熱衝撃過負荷	-65°C/30分 ↔ +150°C/30分、5サイクル 定格電圧 × 2.5、5秒間	±0.05%	±0.01%	±0.005%
±0.05%	±0.01%	±0.005%		
低温貯蔵・動作耐基板曲げ性	-65°C、無負荷放置、24時間 → 定格電圧、45分間 3mmの曲げ、60秒間	±0.05%	±0.01%	±0.005%
±0.05%	±0.01%	±0.005%		
耐電圧絶縁抵抗はんだ耐熱性	大気圧：AC200V、1分間 DC100V、1分間 260°C、10秒間 +65°C ~ -10°C、90%RH ~ 98%RH、定格電圧、10サイクル (240時間)	±0.01%	±0.01%	±0.005%
±0.05%	±0.03%	±0.01%		
±0.05%	±0.03%	±0.01%		
衝撃高周波振動	100G、6ms、のこぎり波、X、Y、Z、各10回 20G、10Hz ~ 2000Hz ~ 10Hz、20分間、X、Y、Z、各2.5時間	±0.02%	±0.02%	±0.01%
±0.02%	±0.02%	±0.01%		
貯蔵寿命	15°C ~ 35°C、15%RH ~ 75%RH、無負荷放置、10000時間	±0.005%	±0.005%	±0.0025%
高溫放置	175°C、無負荷放置、2000時間	±0.05%	±0.05%	±0.03%
寿命	70°C、定格電力、1.5時間ON、0.5時間OFF、2000時間 70°C、定格電力 × 2、1.5時間ON、0.5時間OFF、2000時間	—	±0.01%	±0.005%
		—	±0.03%	±0.01%

*代表値は参考値です。

テーピング仕様 (JIS C 0806に準拠)																	
エンボステークの寸法																	
																	
																	
形式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	A	N	B	C	D	W ₁	W ₂	r
MPP	2.8 ±0.2	3.9 ±0.2	12.0 ±0.3	5.5 ±0.3	1.75 ±0.05	4.0 ±0.1	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	φ1.5 ±0.1	φ178 ±2	φ60 ±2	φ13 ±0.5	φ21 ±0.8	2 ±0.5	12.4 +2.0-0	18.4 以下	1.0 ±0.5
MQP	3.6 ±0.2	5.2 ±0.2	12.0 ±0.3	5.5 ±0.3	1.75 ±0.1	8.0 ±0.1	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	φ1.5 ±0.1-0	テーピング数量 MPP : 1200個 / リール	MQP : 800個 / リール						

単位 (mm)

フェースボンド形チップ抵抗器ご使用上の注意点														
1.保管上の注意点														
1.保管上の注意点 製品の貯蔵・保管環境によっては、外部電極のはんだ付け性を劣化させることができます。特に保管環境が高温多湿の場所や有害ガス雰囲気中の保管は避けてください。 保管場所の標準的な環境は、温度40°C以下、湿度70%RH以下で、周囲の雰囲気に硫黄や塩素が存在しない場所とします。														
2.はんだ付け上の注意点 ①コテ付け法 (ハンド) コテによるはんだ付けは右図に示す条件下で使用して下さい。 推奨条件 •コテ先温度 : 240°C ~ 270°C •コテ電力 : 20W以下 •コテ先径 : φ3mm以下 ②リフロー法 (炉付け) 推奨条件 •はんだ付け温度 : 250+0/-5°C •はんだ付け時間 : 10秒以内 •冷却方法 : 常温中で徐冷 ③浸漬法 (噴流、静止) 推奨条件 •はんだ温度 : 260°C以下 •浸漬時間 : 10秒以内 ④その他留意点 フラックスは腐食性のないロジン系のものをお奨めします。 また、はんだ付け直後は外装樹脂等に機械的な力等を加えぬよう注意してください。														
														
3.洗浄方法														
洗浄液は、メチルアルコール、プロピルアルコール等の揮発性洗浄液をご使用ください。														
4.パターンの設計														
部品をはんだ付けする場合、プリント基板のランド寸法は、部品の寸法やはんだ付け方法により適正な設計が必要です。また、部品実装機や基板材料によっても異なると思われますが、下図に使用例を示します。														
														
形式	A	B	C	D	W ₁	W ₂	r							
MPP	1.6~2.0	0.5~1.5	2.2~2.6	1.8										
MQP				2.5										
単位 (mm)														

部品の実装密度が高い場合には、はんだが多量につき部品の信頼性を損なうことがあります。この場合には部品間にソルダーレジストを塗布し、ランドパターンを分離してください。